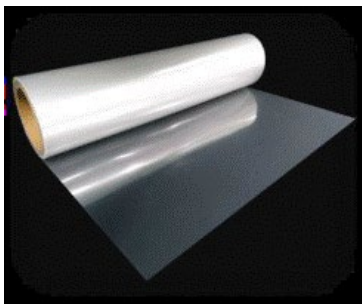


半導体モールド用離型フィルム開発のお知らせ

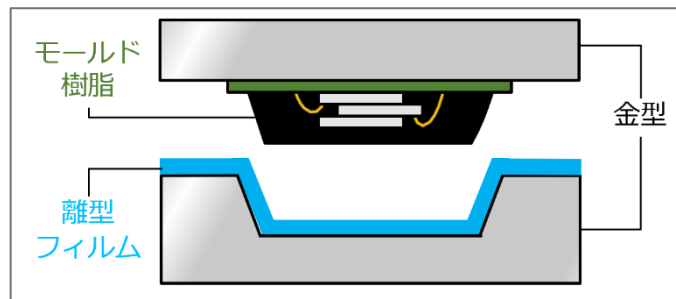
ハリマ化成グループ株式会社

ハリマ化成グループ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長谷川吉弘、以下、当社）は、半導体の製造工程の最適化および環境負荷低減を実現する半導体モールド用離型フィルムを開発しました。現在、国内外顧客へのサンプルワークを進めており、早期の実績化を図るとともに、2030年に向けて市場シェア約30%獲得を目指しています。

半導体製造の後工程であるコンプレッションモールドイング（圧縮成形）では、金型とモールド樹脂の間に離型フィルムを挟み込むことで金型の汚れを抑えます。当社開発品は、高いガスバリア性により成形時に発生する昇華物を遮断することで、清掃頻度をさらに減らし工程改善に大きく寄与します。柔軟性をもった樹脂設計で使用目的に合わせてカスタマイズ可能な上、シリコン・非シリコンの用途に適用し多様な場面でご利用いただけます。有機フッ素化合物（PFAS）フリーで環境にやさしい素材のため、サプライチェーン全体での環境配慮を高めます。



当社開発品



金型とモールド樹脂の間に離型フィルムを使用

■ 開発品の特徴

- ・ガスバリア性が高く、昇華物を遮断
- ・柔軟性の高い樹脂設計のため、使用目的に合わせてカスタマイズ可能
- ・シリコン・非シリコンの用途に適用
- ・PFASフリー構成で、環境にやさしい

■展示会出展のお知らせ

2025年1月22日～24日の間ビッグサイト（東京都）で開かれるアジア最大級エレクトロニクス総合展「ネブコン ジャパン」で紹介する予定です。詳しくはこちらをご覧ください：

<https://www.harima.co.jp/newsroom/2024/1202142237.html>

当社は、以前から半導体向けの樹脂合成技術確立し、急速な成長が見られている生成 AI 分野で、各種電子端末に搭載する半導体の機能を高める機能性樹脂のラインナップで展開しています。今後、これらの技術の活かし用途の多様化を進め、より多くのニーズに応えていきます。

以上

本件に関するお問い合わせ先

ハリマ化成グループ株式会社

広報グループ

TEL：06-6201-2477

URL：<https://www.harima.co.jp/inquiry.php>

ハリマ化成株式会社

樹脂・化成品事業カンパニー 営業部

TEL：06-6201-2464

EMAIL：jyushi-exhibition@harima.co.jp